

证券代码： 688107

证券简称： 安路科技

上海安路信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	参与本次业绩说明会的线上投资者
时间	2024年9月11日下午14:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)
上市公司参加人员姓名	董事、总经理： 文华武 副总经理、财务总监： 郑成 董事会秘书： 吴浩然 独立董事： 戴继雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参加了在上海证券交易所上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)举行的2024年半年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会，以网络文字互动的形式与投资者展开了互动交流。其中部分主要问题及回复如下：</p> <p>Q1：半导体协会近日发布的数据显示，2024年第二季度全球半导体产业销售额累计达1499亿美元，较去年同比增长18.3%，较今年一季度实现6.5%的环比增长，产业行情正持续复苏，对公司影响有多大，如何看待行业后续的发展方向？</p> <p>A：全球集成电路产业在经历了较长时间的高库存、低需求、减少投资和产能调整之后，在新一代通信技术、人工智能与先进计算、智能网联汽车、机器人等新兴领域快速发展的推动下，2024</p>

年开始逐步复苏。在全球科技供应链重构和国产化趋势的双重驱动下，中国 FPGA 市场将实现更高的发展增速。

FPGA 芯片凭借其独特的现场可编程灵活性、出色的并行计算能力以及稳定的低延时等优势，展现了无限的应用潜力和广阔的应用前景。作为广泛应用于工业控制、医疗设备、网络通信、消费电子、数据中心、人工智能和汽车电子等领域的重要芯片之一，FPGA 不仅可以提升数据处理效率，加速算法迭代周期，还能确保设备间的高效无缝协同，这些综合优势共同促进了 FPGA 市场的持续增长。公司未来也将从 FPGA 市场的发展中受益。

Q2：公司今年发年报的时候发了一个提质增效重回报相关的行动方案，请问是否有落到实处，切切实实地保护投资者的权益？

A：公司 2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

经营方面，公司专注于经营主业做优做强，提升经营质量。面对外部环境的挑战，公司坚持技术驱动发展，持续拓宽并强化关键规格产品的布局，满足广泛客户的多样化需求，并优化技术支持服务体系和全流程质量管理体系，提升客户满意度，从而建立更加稳固的市场地位与客户信赖。实现 2024 年第一季度、第二季度营业收入环比持续改善。

研发方面，公司注重提升科技创新能力，增强公司核心竞争力。上半年继续保持高研发投入，优化集成产品开发流程和相关制度体系，完善研发及验证平台建设，多项技术取得突破进展。保障募投项目高质量完成，提升投入产出效益。

同时，公司也在完善治理结构，持续提升规范运作水平，建立有效的激励约束机制，优化组织架构，推动高质量发展。公司始终致力于加强投资者沟通，提升信息披露质量，并积极完善投资者回报机制，提升投资者信心。

Q3：公司去库存进度如何，是否积极采取措施推进？

A：2024 年上半年，公司继续深化库存管控工作，进一步优化库存结构，提升库存周转率，库存管理工作已经初见成效。存

货金额由今年年初的 7.63 亿元降至今年 6 月底的 6.07 亿元，下降了 20.49%。

公司对库存结构进行细化分析，在销售端合理制定了针对不同类型存货的推广策略，实施了一系列去库存的激励措施，加大库存商品的销售力度，实现了库存的良性周转。同时，公司从运营端优化生产计划，精准匹配市场需求，有效避免由过度生产导致的库存积压。公司将持续动态优化去库存策略，为公司未来的灵活运营和可持续发展奠定坚实基础。

Q4：公司在 2024 年上半年在募投项目方面取得进展如何，特别是在研发和产业化方面？

A：2024 年上半年，公司新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目实现了多款 PHOENIX 系列新产品规格开发，进一步丰富 28nm 工艺平台产品矩阵，基于先进工艺的高容量高性能 FPGA 芯片正在支持用户设计导入；现场可编程系统级芯片研发项目完成了低功耗 FPSoC 芯片及高性能 FPSoC 芯片研发，量产型号已应用在视频图像和工业控制等领域，正在支持更多用户导入；发展与科技储备基金项目实现了车规 FPGA 芯片研发和产业化，在新型硬件架构、神经网络加速模块、高性能 IP、EDA 软件前沿算法、先进封装等技术领域实现丰富研发成果，提升了公司在汽车电子、数据中心运算加速等重要领域的技术积累。

Q5：人才是硬科技企业的基石，公司目前人才管理情况如何？

A：公司在 FPGA/FPSoC 硬件设计、专用 EDA 软件设计、应用开发、测试品控、生产运营、市场销售等方面建立了强大的人才队伍，核心技术人员和管理团队长期稳定、高度互补，形成了公司在技术创新、产品研发、工程品质、市场推广等方面的突出优势。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有员工 532 人，其中研发人员 436 人，占公司总人数 81.95%。公司持续优化人才引进策略，健全内部考核与晋升制度，选拔和培养优秀人才。重视人才的全方位成长，通过融合实践经验的内部培训及专业化、系统化的外

	<p>部培训，不断拓宽员工视野，深化其专业技能，驱动公司业务边界的持续拓展与创新。</p> <p>Q6: 贵公司每周微信公众号在各大城市开一场 FPGA 技术研讨会，关注贵公司公众号的基本是老客户。建议公司与工业控制、网络通信、视频图像、汽车电子、数据中心、消费电子、智能电网等领域的头部公司签订合作协议，新用户看到行业头部企业与贵公司合作自然会尝试导入公司的 FPGA 新产品！</p> <p>A: 感谢您的宝贵建议！公司召开技术研讨会的目的也主要是为了维系老客户，开拓新客户。公司也通过多种形式的宣传渠道来进行活动的推广，吸引多领域的客户关注并参与现场。</p> <p>Q7: 请问公司基于高速 SerDes 对高清视频信号传输和处理 HDMI2.0 标准的 HDMI 解决方案是一种怎样的解决方案？</p> <p>A: 该方案主要是针对公司凤凰系列器件拓展视频类应用推出的。</p> <p>有关本次业绩说明会的更多详情请见： https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=20886</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 11 日